



芯片级封装

更优越的功率器件封装:

- 双面冷却可提高散热效率
- 低电感可实现更快速的开关速度
- 不用塑胶封装, 器件可以更小型化、成本更低及提高可靠性

打印此页,
以下就是EPC的
FET及IC的实际大小

